

※本リリースは 2024 年 11 月 26 日に発表されたリリースを訳したものです

タワーセミコンダクター、300mm シリコンフォトニクスプロセスを 標準ファンドリサービスとしてリリース

次世代データ通信アプリケーションのニーズの変化に対応した業界トップクラスの性能を実現

ミグダル ハエメク、イスラエル、2024 年 11 月 26 日-高付加価値アナログ半導体ソリューションのリーディングファンドリである[タワーセミコンダクター\(NASDAQ/TASE: TSEM\)](#)は本日、新たに 300mm シリコンフォトニクス (SiPho) プロセスを標準ファンドリサービスとしてリリースしたことを発表しました。この先端プロセスは、現在量産されているタワーの定評ある 200mm (PH18) プラットフォームを補完するもので、次世代データ通信アプリケーション向けの高速度データ通信の高まるニーズに応えるため、お客様に最先端のソリューションを提供します。

この独自の 300mm プロセスは業界最高クラスのシリコン導波路と最先端の低損失窒化シリコン導波路が採用されています。200mm から 300mm へとウェハサイズを大きくすることで、業界標準の OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) プラットフォームとの高い互換性を実現し、電子部品とのシームレスな統合が容易になることで、全体的な効率を向上させます。

RF 事業部のバイスプレジデント兼ジェネラルマネジャーの Dr. Edward Preisler 氏は次のように述べています。「私たちは、この新しい高度なシリコンフォトニクスプロセスを発表できることを誇りに思います。このプロセスは、既存のお客様が 300mm ウェハを用いた次世代技術への移行をシームレスに進める道を提供します。このプロセスは、タワーの業界をリードする 200mm SiPho プラットフォームの継続的な改良とお客様への供給の柔軟性をさらに高めるものです。」

タワーの RF & HPA テクノロジープラットフォームの詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

タワーセミコンダクタについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーとして、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路 (IC) の技術・開発・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革

新たなアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-imaging sensor、ディスプレイ、パワーマネジメント(BCD および 700V)、フォトニクス、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントを提供し、IDM やファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに 2 か所 (150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)、タワーセミコンダクター が 51%の株式を保有する TPSCo の日本に 2 か所(200mm と 300mm)の生産拠点があり、イタリアのアグラテに 300mm ファブを ST と共有し、またインテルのニューメキシコ州の 300mmファブでも生産可能です。詳細は www.towersemi.com をご覧ください。

Safe Harbor Regarding Forward-Looking Statements

This press release includes forward-looking statements, which are subject to risks and uncertainties. Actual results may vary from those projected or implied by such forward-looking statements. A complete discussion of risks and uncertainties that may affect the accuracy of forward-looking statements included in this press release or which may otherwise affect Tower's business is included under the heading "Risk Factors" in Tower's most recent filings on Forms 20-F and 6-K, as were filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") and the Israel Securities Authority. Tower does not intend to update, and expressly disclaim any obligation to update, the information contained in this release.

Tower Semiconductor Investor Relations Contact: Noit Levy | +972-4-604-7066 | noitle@towersemi.com

Tower Semiconductor Company Contact: Orit Shahar | +972-74-7377440 | oritsha@towersemi.com

